

TIG[®]780-20 是一种膏状导热界面材料，专为各类中低功率电子元器件的散热而设计。材料在典型装配压力与微小填充厚度下，可充分润湿接触表面，有效排除界面空气，形成连续热传导路径。该产品可广泛适用于网络通信、安防监控、家用电器及常规工业控制硬件等对成本与性能均有要求的通用电子设备散热场景。



特性

- 》低粘度
- 》良好的热传导率
- 》优秀的润湿性，可充分浸润接触表面
- 》无毒环保

应用

- 》LED照明
- 》ASICs芯片
- 》CPU、GPU与散热模组界面填充
- 》车载控制单元

TIG[®]780-20 特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
结构&成份	陶瓷填充有机硅	-
最小界面厚度 (mm)	0.036	-
密度 (g/cm ³)	2.8	ASTM D792
黏度 (mPa·s) @25°C	130000	GB/T 10247
建议使用温度范围 (°C)	-45~200	-
击穿强度 (V/mm)	≥6000	ASTM D149
热阻抗 (°C·in ² /W) @30psi	0.047	ASTM D5470
导热系数 (W/m·K)	2.0	ASTM D5470
	2.0	ISO22007

全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的。产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担。Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIG780-20-0526